



第12回レーザー協会地方講演会

established in 1972

『ものづくりのためのレーザー』

日時：2018年1月10日(水) 13:00～16:45

会場：サンポートホール高松 61 会議室

〒760-0019 香川県高松市サンポート2番1号

<http://www.sunport-hall.jp/>



13:00～13:10 開会挨拶 レーザ協会会長 庄司 一郎

13:10～13:40 講演1(総論) 「レーザー加工の現状と将来 -ものづくりの中のレーザー加工-」

中央大学 新井 武二

13:40～14:10 講演2 「レーザー用透明セラミックス」

神島化学工業(株) 武正 知久

14:10～14:40 講演3 「レーザーによる切断と穴あけ加工機の最新動向」

三菱電機(株) 金岡 優

14:40～15:00 休憩

15:00～15:20 講演4 「レーザー照射とめっきによるパワー半導体ガラス基板のマスクレス配線形成」

岡山県工業技術センター 水戸岡 豊

15:20～15:40 講演5 「レーザー積層造形法による SUS316 造形体の作製」

香川県産業技術センター 宮内 創

15:40～16:10 講演6 「デポジション方式金属3D積層造形の特徴と適用可能性について」

三菱重工工作機械(株) 二井谷 春彦

16:10～16:40 講演7 「レーザーの強度分布を変える -卓上フライス盤で作るビームシェイパー」

千葉工業大学 徳永 剛

16:40～16:45 閉会挨拶

参加費：無料

申込方法：参加人数把握のため、事前にレーザー協会ウェブページ(<http://jslt.jp/>)の地方講演会申し込みフォームからお申し込みください。ただし、当日申し込みも受け付けます。

問合せ先：レーザー協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp